



## LOTPASTE SC BLF05

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC BLF05 ist die aktuellste, zukunftsweisende, Kreation, auf dem Gebiet **Bleifrei-Löten**, speziell für das Löten in der Dampfphase (vapor phase) oder unter Schutzgas konzipiert. Eine einschlägige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet und die dauerhafte Zusammenarbeit mit den Benutzern und Produzenten von Dampfphaseöfen, auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC-, und MIL-Normen haben zu dieser Entwicklung beigetragen.

Die SC BLF05 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem bleifreiem Lotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunststoffbasis**, das der RE L0 nach J-STD 004 (F-SW33) entspricht und dadurch zu den allerneuesten **extrarückstandsarmen, bleifreien** "Stickstoff oder vapor phase"-Lotpasten gehört.

Außer der absolut hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- \*SC BLF05\* Wasserklarer, kaum sichtbarer Rückstand von nur 1,8 % !
- \*SC BLF05\* Kein Grabsteineffekt ("tombstoning")
- \*SC BLF05\* Enthält Korrosionsinhibitoren
- \*SC BLF05\* Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang!
- \*SC BLF05\* Keine Verschmutzung der Lötanlagen mit teerartigen Rückständen
- \*SC BLF05\* Exzellente Lötergebnisse, auch bei 5% Restsauerstoff in N<sub>2</sub>-Anlagen

### PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	Schmelzpunkt	Gemäß Internationalen Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:	
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.3	25 - 45 µm
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 – 219°C	Kl.4	20 - 35 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	Kl.5	10 - 25 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C		

**VISKOSITÄT** (Pa.s) +/-10% gemessen mit Brookfield RVT-DV Viskosimeter bei 91% Metallgehalt

<u>Viskosität:</u> *		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
650 - 750 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
700 - 800 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

**OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR)** und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messungen am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	2,8x10 <sup>13</sup>	3,5x10 <sup>13</sup>

## QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC BLF05 ist sowohl eine Vapor Phase Lotpaste, als auch eine N<sub>2</sub>- Paste, die den Anforderungen der führenden Häuser auf dem Gebiet des Dampfphase- und Stickstofflötens entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der J-STD 004; RE L0 (no-clean) entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können, auch unter dem Schutzlack.

## VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst fest verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren als Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100 mm/s.

Merke(!) Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 91% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Für diesen Vorgang empfehlen wir deswegen den **SC Schablonenreiniger!**

## LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

## So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Fluxgehalt	Gebindegröße
z.B.	SC BLF05	T3	96,5/3,5Ag	09%	500g
	SC BLF05	T3	96,5/3,0Ag/0,5Cu	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...)      L-Sn96,5Ag3,5 / F-SW 33 / 90-3      200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut  
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020  
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.